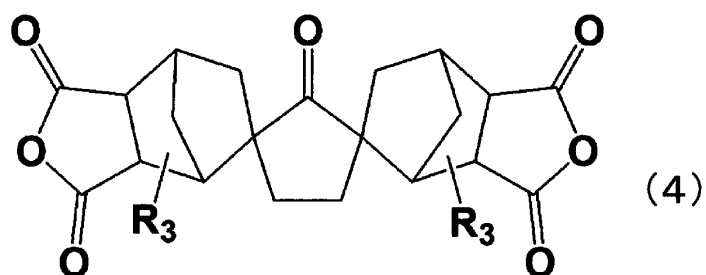
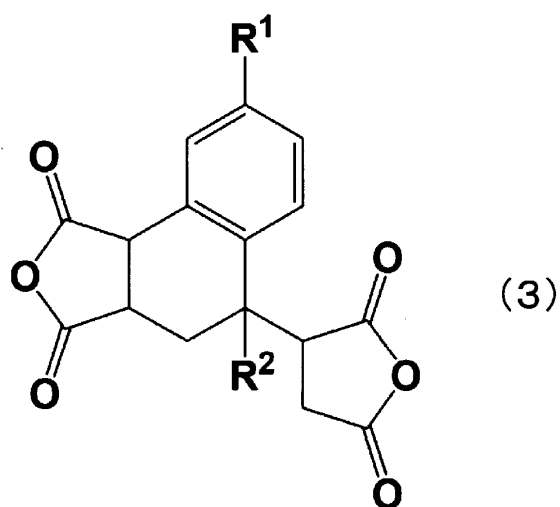


請求の範囲

- [請求項1] (A) 高分子化合物、及び (B) カチオン重合性化合物を含有する樹脂組成物であって、
- 前記 (A) 高分子化合物は、ポリアミド、ポリイミド、ポリアミドイミド、及びポリベンゾオキサゾールからなる群より選ばれる少なくとも1つの化合物であって、
- さらに (C) カチオン重合開始剤を含有することを特徴とする樹脂組成物。
- [請求項2] 前記 (A) 高分子化合物の分子鎖末端がカルボン酸残基に由来する構造であることを特徴とする、請求項1に記載の樹脂組成物。
- [請求項3] 全ての樹脂組成物の合計を100質量%とした場合、前記 (A) 高分子化合物が30～70質量%、前記 (B) カチオン重合性化合物が30～70質量%であることを特徴とする、請求項1または2に記載の樹脂組成物。
- [請求項4] 前記 (A) 高分子化合物は、カルボン酸残基の合計を100モル%とした場合に、アミン残基の合計を60～98モル%として重合させて得られる化合物であることを特徴とする、請求項1～3のいずれかに記載の樹脂組成物。
- [請求項5] 前記 (A) 高分子化合物は、ポリアミド、ポリイミド、及びポリアミドイミドからなる群より選ばれる少なくとも1つの化合物であって、さらに、脂環式テトラカルボン酸二無水物に由来する構造を有することを特徴とする、請求項1～4のいずれかに記載の樹脂組成物。
- [請求項6] 前記 (A) 高分子化合物の分子鎖末端がカルボン酸残基に由来する構造が、テトラカルボン酸二無水物に由来する構造であることを特徴とする請求項1～5のいずれかに記載の樹脂組成物。
- [請求項7] 前記 (A) 高分子化合物が、下記一般式 (3) または (4) の少なくとも一方で表される化合物に由来する構造を有することを特徴とする、請求項1～6のいずれかに記載の樹脂組成物。

[化1]



(式中、 R^1 、 R^2 、 R^3 は、それぞれ独立に、水素原子またはメチル基を表す。)

[請求項8] 前記(A) 高分子化合物は、分子鎖内にフェノール性水酸基を有する化合物であることを特徴とする、請求項1～7のいずれかに記載の樹脂組成物。

[請求項9] 前記(B) カチオン重合性化合物は、常温で液状である多官能エポキシ化合物であって、エポキシ当量が80～160 g/eq.であることを特徴とする、請求項1～8のいずれかに記載の樹脂組成物。

[請求項10] 前記(C) カチオン重合開始剤は、スルホニウム塩であることを特

徴とする、請求項 1～9 のいずれかに記載の樹脂組成物。

- [請求項11] 請求項 1～10 のいずれかに記載の樹脂組成物から形成された樹脂組成物被膜を有する樹脂組成物フィルム。
- [請求項12] 前記樹脂組成物被膜を 200 度で加熱した時の重量減少率が 0.01～1.0%であることを特徴とする、樹脂組成物フィルム。
- [請求項13] 前記樹脂組成物被膜の 40℃での熔融粘度が、 $0.5 \times 10^6 \sim 1.0 \times 10^7 \text{ MPa} \cdot \text{s}$ であることを特徴とする、請求項 11 又は 12 に記載の樹脂組成物フィルム。
- [請求項14] 前記樹脂組成物被膜を熱硬化させた後の 180℃でのクリープ変形量が、0.5～2.5%であることを特徴とする、請求項 11～13 のいずれかに記載の樹脂組成物フィルム。
- [請求項15] 請求項 1～10 のいずれかに記載の樹脂組成物または請求項 11～14 のいずれかに記載の樹脂組成物フィルムの樹脂組成物被膜を硬化した硬化膜。
- [請求項16] 請求項 15 に記載の硬化膜が、中空部分を有する構造体（以下、中空構造体という）の屋根部分として用いられたことを特徴とする中空構造体。
- [請求項17] 前記屋根部分の厚みが、 $10 \sim 30 \mu\text{m}$ であることを特徴とする、請求項 16 に記載の中空構造体。
- [請求項18] 請求項 16 又は 17 に記載の中空構造体の外周部が、モールド樹脂で封止された構造であることを特徴とする電子部品。